

2024年度名古屋大学工学部・工学研究科
UPWARDS半導体サマープログラムへの派遣募集について（通知）

2023年5月に開催された広島サミットにおいて、UPWARDS（半導体の人材育成と研究開発に関する未来に向けた日米大学間パートナーシップ）が創設されました。

UPWARDSはマイクロン財団、マイクロン社及び東京エレクトロン（株）からの資金提供に基づき、日本側5大学（名古屋大学、東北大学、東京工業大学、広島大学、九州大学）と米国側6大学（レンセラー工科大学、ロチェスター工科大学、パデュー大学、ワシントン大学、ボイシー州立大学、バージニア工科大学）が本枠組みに参画し、日米大学間での主に女子学生を中心とした半導体分野の人材育成・人材交流を行うプログラムとなります。

この度、名古屋大学工学部および大学院工学研究科では、米国側UPWARDS参画大学であるレンセラー工科大学及びロチェスター工科大学が実施する半導体サマープログラムに派遣する学生を下記により募集します。

記

1. 応募資格 名古屋大学工学部，工学研究科に在籍する現学部2年生以上
 （派遣時3年生以上）及び大学院学生で、半導体分野を専攻する者または半導体分野への興味を有する者
 なお、UPWARDSの趣旨から、日本国籍保持者または日本国永住者のみを対象とする。
2. 派遣対象大学 ① レンセラー工科大学（RPI）
 ② ロチェスター工科大学（RIT）（九州大学との合同派遣）
3. プログラム期間 ① 令和6年7月8日（月）～7月19日（金）
 ② 令和6年8月9日（金）～8月23日（金）（注）
 （注）プログラム終了後、TELアルバーニ工場見学を調整中
4. 派遣人数 ①，②ともに8名程度（うち半数以上は女子学生とする。）
5. 参加費用 パスポート，ESTA取得費用，海外旅行保険料及びプログラムに含まれない
 現地食事代・課外活動費用については，参加者負担とする。
 なお，渡航のための航空券代及び半導体プログラム参加費用は大学負担とする。
6. 応募締切 令和6年3月25日（月）正午
7. 書類提出先 工学部・工学研究科教務課留学生係 魚津（内線 3563）
 E-mail: kou-ryu@t.mail.nagoya-u.ac.jp

8. 提出書類

- (1) 派遣希望願（所定様式1）
- (2) 志望理由書（所定様式2）
- (3) 英語能力証明書の写し ※取得日は問わない。名古屋大学で受験したTOEFL-ITPも可。
- (4) 学業成績証明書（自身で証明書発行機から印刷）

9. 選考結果通知 令和6年3月29日（金）

10. 注意

- (1) 応募書類を提出する前に、予め指導教員の承認を得ておくこと。
- (2) 応募者多数の場合には、選考結果通知送付に先立ち、面接選考を実施する場合がある。
詳細については、応募者に追って通知する。
- (3) 以下に定める英語能力を有すること
基本的な英語コミュニケーションやTechnical Term（専門用語）がわかること。
IELTS5.0やTOEFL iBT70以上あることが望ましい。
- (4) 帰国後、1か月以内に帰国報告書（様式3）を提出すること。
帰国報告会への出席、その他、UPWARDS関係プログラムへの参加を求める場合がある。
- (5) 派遣期間中名古屋大学工学部・工学研究科に在籍していること。
ただし、非正規生としての在籍は除く。
- (6) ①レンセラー工科大学は、春学期の授業期間中、※
②ロチェスター工科大学は、本学の大学院入試（令和6年8月20日～23日
（予定））と重なるので、応募時に注意すること。
- (7) レンセラー工科大学、ロチェスター工科大学が実施するプログラムの概要は、
別紙を参照すること。

※(R6.3.11追記) 本学の大学院入試筆記試験免除面接試験（令和6年7月20日予定）
と重なるので、応募時に注意すること。

Chips@Rensselaer Summer Immersion Program

July 8-19, 2024

Rensselaer Polytechnic Institute, Troy NY

Rensselaer Polytechnic Institute (RPI) and Nagoya University invite nominations for undergraduate and graduate students at Nagoya University interested in a 2-week residential chips/STEM immersion experience on the beautiful and historic RPI campus in upstate New York, USA.

Highlights of the two-week summer immersion program include the following.

Knowledge, Culture, and Leadership

- **Academic Lectures** by top technologists and researchers in the field of semiconductors fundamentals and applications to AI, Quantum, Robotics, Manufacturing, Imaging, Human Health, and other areas. The program will also include exposure to *how to do good research*.
- **Culture, English Language immersion** led by experts familiar with Japanese and American culture.
- **Leadership and Communication** – exposure to concepts in communication and leadership in the modern technological world.

Hands-on Experience

- RPI's clean room and other experiential laboratories (e.g., the Mercer-X Lab, the Forge Maker Space, Manufacturing Innovation Learning Lab, and other facilities) to learn basic skills.

Campus Life

- Tours of RPI facilities – Center for Biotechnology and Interdisciplinary Studies, Experimental Media and Performing Arts Center, and other facilities
- Participation in social events, BBQ

Local tours and field trips

- Field trips to Global Foundries, Albany Nanotechnology Complex, General Electric
- Excursions in the beautiful upstate NY region – weekend hike in Adirondack Mountains, boat ride in lake George, Cohoes Falls, and more.

(別紙：ロチェスター工科大学が実施するプログラム概要)

Rochester Institute of Technology Summer Immersion Program

August 9-23, 2024

Short course training on IC Tech:

This course provides a comprehensive, hands-on educational experience in integrated circuit process engineering through a combination of lectures and cleanroom based laboratories. Participants not only learn about semiconductor device structures and the processing steps to fabricate them, but are also exposed to CAD layout, mask making basics, IC testing, and SPC methodology as well. A four-level metal gate PMOS process is used to fabricate the student designs on 150mm Si wafers using i-line stepper lithography.

Cultural Outings:

Visit of Niagara Falls with Maid of the Mist cruise, 2 local museum visits, and other arts or sports events. Visit to local companies will be included too.

Campus activities:

Joint seminars, group lunch/dinner with RIT faculty and students, lab tours, and etc.

(様式1)

派遣希望願

令和6年 3月 日

工学部長・工学研究科長 殿

指導教員 _____ 印

所属 _____ 学科 _____ 年
博士課程 (_____ 課程)
専攻 _____ 年

氏名 _____

希望する派遣先

第1希望 _____ 大学

第2希望 _____ 大学

(いずれか一方の場合は、第1希望のみ記入すること。)

英語能力試験スコア

TOEFL iBT _____ 点 IELTS _____ TOEIC _____ 点
(取得日 _____) (取得日 _____) (取得日 _____)

上記以外の英語スコア _____

(名古屋大学で受験したTOEFL ITPを含む)

このたび、令和6年度UPWARDS半導体サマープログラムへの参加を希望しますので、下記の書類を添えて申請いたします。

記

- (1) 派遣希望願 (所定様式1)
- (2) 志望理由書 (所定様式2)
- (3) 英語能力証明書の写し
- (4) 学業成績証明書

(様式2)

志 望 理 由 書

氏 名 _____

希望する派遣先

第1希望 _____ 大学

第2希望 _____ 大学

(いずれか一方の場合は、第1希望のみ記入すること。)

本プログラムの志望動機や自身の研究内容，半導体分野への興味・関心，派遣先大学で実施したい内容等について，500～800字程度で記載してください。

(様式3)

帰国報告書(半導体サマープログラム)

年 月 日

工学部長・工学研究科長 殿

所 属 学 科 年
博 士 課 程 (課程)
専 攻 年

氏 名 _____

(1) 派遣先大学、学科・専攻名 ○○○○大学

(2) 派遣期間
年 月 日 ~ 年 月 日

(3) 派遣中の活動概要、感想、派遣で得られた成果など